

DKZ/33/2009

Warszawa, dnia 23.04.2009r.

Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
dostawę urządzenia do montażu nanostruktur typu wire bonder
słownik CPV 31700000

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej: 206 000,00 euro.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46

adres internetowy: <http://www.ite.waw.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy.

Oferty złożone w postępowaniu zostaną otwarte i ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Spośród wszystkich, nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg kryteriów oceny ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, **urządzenia do montażu nanostruktur typu wire bonder**, zwanego dalej „**urządzeniem**” wraz z instalacją i uruchomieniem.

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia przedstawione są w załączniku nr 1 do siwz.

4. Składanie ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 6.1 spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu o ubieganie się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

- 6.2 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 10 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem odbiorców tych dostaw.

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7 siwz.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Status prawny – wymagane dokumenty:

- 7.1 Oświadczenie, o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, [załącznik nr 2 do siwz];
- 7.2 Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę, za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];
- 7.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zdolność techniczna - wymagane dokumenty:

- 7.4 Wykaz wykonanych dostaw – wymieniony w pkt. 6.2 siwz,

Brak złożenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr Michał Urbański e-mail urbanski@ite.waw.pl.

Pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46,
02-668 Warszawa.
Zespół Zamówień Publicznych
Budynek VI, pokój nr 216.

Fax: + 48 22 548 78 46

9. Wymagania dotyczące wadium: nie wymagamy

10. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi : 30 dni.

11. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy złożyć na piśmie.

Oferta powinna zawierać:

- a) dokładną nazwę i adres oferenta,
- b) datę sporządzenia oferty,
- c) wypełniony załącznik nr 1 do siwz,
- d) cenę netto w PLN (dopuszcza się podanie ceny w EUR lub USD. W przypadku złożenia ofert w EUR lub USD dla porównania cen ofert zastosowany zostanie przelicznik na złote polskie – PLN. Przelicznik ten będzie zgodny z kursem sprzedaży walut NBP jaki będzie obowiązywał w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert),
- e) termin wykonania zamówienia,
- f) okres gwarancji,
- g) wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom [załącznik nr 3 do siwz].

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w punkcie 7 niniejszej siwz.

W przypadku udziału w postępowaniu firm spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się złożenie oferty, a także dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji w języku polskim lub w języku angielskim.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **05.05.2009 r.** do godziny **10:00** (w dni robocze w godz. 9:00÷14:00) w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 216. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 120.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02 – 668 Warszawa. Budynek VI, pokój 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na „dostawę urządzenia do montażu nanostruktur typu wire bonder” – nie otwierać do dnia 05.05.2009 r. do godz. 10:15.

13. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena netto podana w PLN (EUR lub USD) powinna obejmować:

- a) urządzenie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do siwz,
- b) transport, rozładunek i posadowienie
- c) warunki dostawy: DDP Warszawa,
- d) ubezpieczenie,
- e) instalację,
- f) uruchomienie i testy akceptacyjne,
- g) szkolenie 3 osób w siedzibie zamawiającego.

16.2 Gwarancja:

- 1) Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego przez siebie urządzenia w ciągu (okres gwarancji w ofercie) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
- 2) Dostawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak również pokrywa koszty związane z jego transportem.
- 3) W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Kupującego, Dostawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później niż w okresie 12 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek.
- 4) Gwarancja zostanie przedłużona o czas ewentualnej naprawy urządzenia.
- 5) Wymienione lub naprawione części zostaną objęte gwarancją Dostawcy lub Producenta.
- 6) W okresie gwarancji, Dostawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterek.

16.3 Warunki płatności:

Płatność zostanie dokonana w następujący sposób:

- 1) 60% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury i dokumentów przewozowych na konto Dostawcy w czasie dostawy, po wykonaniu wstępnego testu akceptacyjnego w siedzibie Dostawcy i po podpisaniu przez obie strony Umowy protokołu odbioru wstępnego.
- 2) 40% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury na konto Dostawcy w ciągu 21 dni od daty wykonania końcowego testu akceptacyjnego w siedzibie Kupującego i podpisania przez obie strony Umowy protokołu odbioru ostatecznego.

Kupujący zapłaci Dostawcy przekazem bankowym kwotę za przedmiot umowy na konto Dostawcy w:

.....
.....

Koszty bankowe na terenie Polski ponosi Kupujący, a poza jej granicami – Dostawca.

16.4 Instrukcja dostawy:

- 1) Przedmiot umowy będzie wysłany na poniższy adres i pozostawiony do dyspozycji Kupującego.

Adres dostawy: Instytut Technologii Elektronowej,
 Al. Lotników 32/46,
 02-668 Warszawa, Polska

- 2) Dostawca zawiadomi Kupującego faksem o wysyłce (Nr +48 22 54-87-803).
- 3) Dostawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy deklarację zgodności CE urządzenia.

16.5 Odbiór przedmiotu umowy:

Uruchomienie urządzenia obejmuje rozruch techniczny oraz wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających jego parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją techniczną i wymaganiami określonymi w siwz. Potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru ostatecznego.

16.6 Rozstrzyganie sporów:

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, których nie da się wyjaśnić polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu.

17. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: nie wymagamy.

18. Tryb udzielania wyjaśnień na temat siwz:

Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego w formie pisemnej, faksem oraz pocztą elektroniczną o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie, jeżeli wpłyną do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dostęp do powyższych informacji - strona internetowa www.uzp.gov.pl).

20. Inne:

Do spraw nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Zbigniew Poznański

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu nanostruktur typu wire bonder.

Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *
1	2	3	4
1.	Typ urządzenia		podać
2.	Rok produkcji	2009	potwierdzić
3.	Kraj producenta urządzenia		podać
4.	Producent urządzenia		podać
5.	Urządzenie	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.	Potwierdzić
6.	Wymagania ogólne	Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania połączeń drutowych pomiędzy przyrządami na bazie półprzewodników AIII – BV (emitery, detektory), ceramikami, złożonymi chłodnicami miedzianymi. Możliwość wykonania połączeń pomiędzy elementami o różnych wysokościach.	potwierdzić
7.	Rodzaje procesów	Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy ceramiką a przyrządami półprzewodnikowymi (emitery, detektory). Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy przyrządami półprzewodnikowymi. Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy ceramikami. Wykonywanie połączeń drutowych, aluminiowych oraz złotych, pomiędzy ceramikami a pozłożonymi elementami miedzianymi. Wykonywanie połączeń zarówno typu <i>ball bond</i> oraz <i>wedge bond</i> , w każdym z wymienionych wyżej przypadków.	potwierdzić
8.	Półautomatyczne urządzenie	Urządzenie pozwala wykonywać półautomatycznie lub automatycznie połączenia zarówno typu <i>ball bond</i> oraz <i>wedge bond</i> ,	potwierdzić
		Z automatycznym przesuwem w osiach X,Y,Z, sterowane komputerowo.	potwierdzić
		Wyposażone w monitor do podglądu podczas pracy.	potwierdzić
		Ręczne podawanie płytek/przyrządów/ceramik na stolik montażowy.	potwierdzić

		Dokładność przesuwu w osiach X, Y lepsza niż 0,3 μ m.	potwierdzić, podać
		Powtarzalność wykonania połączeń lepsza niż 3 μ m.	potwierdzić, podać
		Wymiary urządzenia max. 80cm(H)x80cm(W)x75cm(D).	potwierdzić, podać
9.	Głowica stosowana podczas wykonywania połączeń typu <i>ball bond</i>	Możliwość wykonywania połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 18 μ m – 50 μ m.	potwierdzić, podać
		Oświetlenie głowicy podczas wykonywania połączeń.	potwierdzić, podać
		Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.	potwierdzić
		Wyposażona w podstawowy zestaw z drutem Au lub Al.	potwierdzić, podać
10.	Głowica stosowana podczas wykonywania połączeń typu <i>wedge bond</i>	Możliwość wykonywania połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 18 μ m – 70 μ m.	potwierdzić, podać
		Oświetlenie głowicy podczas wykonywania połączeń.	potwierdzić
		Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.	potwierdzić
		Wyposażona w podstawowy zestaw z drutem Au lub Al.	potwierdzić, podać
11.	Oświetlenie stolika	Zapewnione.	potwierdzić, podać
12.	Podgrzewany stolik dla podłoża z mechanicznym i próżniowym mocowaniem	Co najmniej dla podłoża 3"x3".	potwierdzić, podać
		Regulacja temperatury co najmniej do 200 ⁰ C.	potwierdzić, podać
		Kontroler temperatury stolika.	potwierdzić
13.	Generator ultradźwięków	Zapewnione.	potwierdzić
14.	Automatyczna kontrola i pomiar deformacji połączeń	Zapewnione.	potwierdzić
15.	Możliwość modelowania różnego kształtu połączeń drutowych	Zapewnione.	potwierdzić
16.	Możliwość kontroli optycznej (mikroskop) podczas pracy	Zapewnione.	potwierdzić
17.	Sposób sterowania	Sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie Windows XP Pro.	potwierdzić
18.	Dwuetapowy test akceptacyjny:	Wykonanie połączeń drutowych aluminiowych oraz złotych typu <i>ball bond</i> oraz <i>wedge bond</i> pomiędzy:	potwierdzić
	a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy b) Końcowy test	- ceramiką a przyrządami półprzewodnikowymi (emitery, detektory). - przyrządami półprzewodnikowymi. - ceramikami.	

	akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego	- ceramikami a pozłoconymi elementami miedzianymi. Sprawdzenie automatycznej kontroli i pomiaru deformacji połączeń. Sprawdzenie możliwości modelowania kształtu połączeń drutowych. Wykonywanie co najmniej 10 połączeń drutowych w każdym z wymienionych wyżej przypadków. (struktury testowe zapewnia zamawiający)	
19.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 4 tygodnie	Zapewnione.	potwierdzić, podać
20.	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego	Zapewnione.	potwierdzić
21.	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim	Zapewnione.	potwierdzić, podać
22.	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty instalacji	Zapewnione.	potwierdzić
23.	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji	Zapewnione.	potwierdzić
24.	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji	Zapewnione.	potwierdzić
25.	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy	Zapewnione.	podać

*** Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty**

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

.....
data

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

(W przypadku braku podwykonawców, należy wypełnić wykaz kreskami.)

Lp.	Zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej